

广东奥普特科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒现场参观 ☒其他线上会议、券商策略会
参与单位名称	Acuity Consulting Limited、Capital Research Global Investors、Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited、Fidelity Invs、FIL – Hong Kong、FIL(大连)、Goldman Sachs、Grand Alliance Asset Mgmt Ltd、Harding Loevner、HSZ (Hong Kong) Limited、Janchor Partners、Jefferies、Jefferies HK、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Panview Capital、Point 72、Point72 Hong Kong Ltd、Triata Capital Ltd、Vision Point Asset Mgmt、爱建证券、百年保险、宝盈基金、博道基金、财通基金、财通证券、辰泰顾问、创金合信基金、慈阳投资、大成基金、大和证券、大和资本(香港)、德汇投资、东北证券、东方阿尔法、东方财富、东方红、东方证券、东吴基金、东吴证券、东亚前海、东证融汇、方正证券、冯源（宁波）私募、富国基金、耕霖（上海）投资、光大保德信基金、光大永明、光大证券、广发基金、广发证券、归德私募、国海证券、国金证券、国金证券资管、国联安基金、国盛证券、国寿安保基金、国泰海通、国泰基金、国投证券、国信证券、国元证券、浩成资产、恒洵投资、恒越基金、弘尚资产、花旗环球、华安基金、华福证券、华强集团、华商基金、华泰柏瑞、华泰证券、华西证券、华夏基金、华夏久盈、汇丰、汇丰晋信、汇丰前海、汇正财经、嘉世基金、建信基金、精砚基金、景顺长城、九方云、开源证券、凯基证券、昆仑健康保险、朗程投资、麦格里上海、麦格里、美林(亚太)、民生加银基金、明河投资、摩根大通、摩根士丹利、南方基金、南京证券、农银人寿、诺安基金、盘京投资、磐泽资产、鹏华基金、平安养老、前海开源基金、日兴证券、荣金资产、瑞穗证券、瑞银证券、睿目投资、山西证券、上海证券自营、申万宏源、申银万国、盛博香港、施罗德投资、硕丰基金、苏新基金、太平洋证券、太平洋资产、泰康资产、泰昇私募、泰信基金、万家基金、西部利得、西部证券、西南证券、橡果资产、鑫融长弘、信达澳亚、兴业证券、兴证全球基金、野村东方、野村香港、易方达、益昶资产、银华基金、永盈基金、于翼资产、圆信永丰、云禧基金、鑿义创投、泽铭投资、长城基金、长城证券、长江证券、长信基金、招商证券、浙商证券、中国投资、中国银河证券、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、中银国际、中邮证券、钟港资本。

投资者关系活动主要内容介绍	问题1：介绍下公司 2026 年上半年业绩情况？ 回答：2026 年上半年，面对下游行业需求分化、产品技术迭代加快及市场竞争持续加剧的经营环境，公司围绕机器视觉核心业务，持续推进重点行业应用拓展、视觉 AI 技术研发、产品平台迭代及业务协同，实现业绩的稳健增长。2026 年上半年，公司实现营业收入 90,413.97 万元，较上年同期增长 32.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,049.97 万元，较上年同期增长 16.78%，整体经营保持稳健。 从收入结构看，3C 电子仍为公司第一大下游行业，但随着锂电业务稳步增长以及半导体、汽车等业务较快拓展，公司收入来源进一步多元化。2026 年上半年，3C 电子、锂电、半导体和汽车行业收入分别为 42,609 万元、23,033 万元、10,998 万元、4,701 万元，占比分别为 47.13%、25.47%、12.16%和 5.20%。公司业务结构的变化，反映了前期行业应用拓展、技术研发和产品布局正在逐步形成新的业务支撑。 问题2：今年上半年半导体行业增长明显的主要驱动因素？ 回答：公司半导体业务收入快速增长，既受益于半导体设备产业链国产替代以及 AI 需求带来的行业发展机遇，也得益于光模块等 AI 算力基建相关硬件制造行业的高景气。 在半导体设备领域，芯片制造全流程工艺精密、制程壁垒高，覆盖晶圆制造、中道加工、后端封测、精密分选等核心环节。其中机器视觉承担晶圆/芯片边缘定位、微米/亚微米级尺寸量测、图形套刻对位、表面瑕疵检测、晶粒姿态识别、字符码读取、光路对位校准、异物脏污筛查等核心功能，全方位把控芯片制程精度与产品良率；运动控制则负责多轴高速精准位移、洁净环境下柔性对位、晶圆自动传输与设备精密进给等动作执行。2026 年上半年，公司机器视觉及运控产品逐步深度应用于晶圆制造量检测、晶圆划片切割、固晶共晶倒装贴装、激光微加工、半导体 AOI 检测、精密点胶清洗、塑封切筋、芯片测试分选、先进封装微组装等高端装备领域，覆盖晶圆分割、芯片贴装键合、缺陷检测、成品分选等核心工序，适配功率器件、光芯片、第三代半导体等产品的生产场景，已配套供货多家国内主流半导体设备厂商。 在光模块环节，相关生产制造工序工艺复杂且流程精密，精密制造设备高度依赖机器视觉与运动控制协同配套：机器视觉承担元器件识别、微米级定位、尺寸测量、光路校准、外观缺陷检测等工作，运动控制完成多轴高精度位移、柔性对位、物料自动移送等动作执行。报告期内，公司视觉与运控产品批量应用于贴片、耦合、自动化组装及光学检测等相关设备。
----------------------	---

	公司依托光学成像、工业相机、3D 视觉、视觉软件及工业 AI 等技术积累，持续参与下游设备商、生产线及制造企业的项目开发。2026 年上半年，公司新增多家半导体客户，存量客户的订单及业务收入持续增长。随着相关产品验证和应用场景逐步拓展，半导体业务已成为公司业务结构延展的重要战略方向。 问题3：介绍下公司工业 AI 增长情况以及未来规划？ 回答：2026 年上半年，公司工业 AI 相关系统解决方案实现收入 18,160 万元，同比增长 107.94%。凭借成熟的工业 AI 核心能力，公司 AI 系统解决方案已全面覆盖 3C 电子、新能源、半导体、汽车、医药、物流等高端制造业领域，深度应用于手机、锂电池等主流产品全生产工序，并在光模块、PCB 及晶圆检测等场景实现批量应用。同时，公司积极布局“AI+机器人”协同系统，打造“手眼脑”一体化具身工业解决方案，深度融合视觉感知与具身智能机器人能力，基于工业 AI 与行业大模型构建具备“边运行、边学习、边优化”能力的柔性产线，有效提升产线柔性制造能力、柔性制造水平，简化人工操作流程，升级质量管控体系，全方位助力制造企业降本、增效、提质。 未来，公司将持续推进视觉 AI 与光学成像、工业相机、3D 视觉和运动控制等核心产品的深度融合，持续优化视觉软件和算法平台的易用性、模块复用性及复杂场景适配能力。从行业趋势来看，制造业自动化升级、品质提升、柔性化生产普及、机器人规模化应用，将持续释放机器视觉增量需求。短期来看，公司将紧跟 3C 电子、新能源、半导体、汽车等核心行业的技术迭代节奏和资本投入变化，依托标准化产品、平台化能力、场景化定制方案，精准承接行业发展机遇，持续扩大工业 AI 的产业赋能价值。 问题4：介绍下公司 3D 产品进展情况？ 回答：（1）优化量产管控体系，实现提质降本与规模化交付 基于上一代产品在高精度成像、高速采集、复杂工业工况适配等方面的成熟技术基础，今年上半年，公司 3D 产品线聚焦供应链体系优化与量产能力建设，建立标准化生产管控流程与精细化成本管控机制。通过产能升级、工艺标准化革新及全流程品控体系优化，公司在稳定产品核心性能的前提下，有效实现规模化提质降本，显著提升产品批量生产一致性与工业工况适配稳定性。目前，公司已具备大批量、高可靠、快响应的交付能力，是国内少数可实现高端 3D 视觉设备稳定量产的核心原厂，能够充分满足下游制造业客户规模化、持续性的配套生产需求。 （2）核心技术持续迭代，关键性能指标跻身行业一流水平 公司持续深耕 3D 成像核心底层技术，通过优化光学核心组件、升级整
--	---

	机装配工艺、迭代自研核心算法，有效攻克行业普遍存在的温漂扰动、视野畸变、边缘精度衰减等技术痛点。 （3）完善全域产品矩阵，模块化平台化赋能多场景应用 公司坚持平台化、模块化、场景化的产品研发策略，持续丰富 3D 视觉全品类产品布局，多款新品填补国内细分高端领域市场空白，全面覆盖高端精密制造、工业自动化、智慧物流等核心应用赛道。 （4）拓展高端仪器赛道，构建模块化精密检测平台 依托成熟的 3D 机器视觉全栈技术能力，公司向上延伸产业链布局，切入高端精密检测仪器赛道，对标行业头部品牌，自主研发推出 3D 超景深显微检测设备。设备搭载公司自研亚微米级飞拍超景深合成技术，微观成像合成精度可达亚微米级，满足高端微观精密检测的核心技术要求。 产品采用高度集成化、模块化设计，支持多规格通用底座适配，可快速切换轮廓测量、白光干涉、面共焦等多种功能采集头，实现单设备多场景复用，有效降低客户设备采购成本与使用学习成本。同时，设备独立采集模块可单独作为工业在线检测硬件使用，兼容行业主流算法平台，可有效解决工业生产中各类高难度、高精度的 3D 检测技术难题。 问题5：今年上半年东莞泰莱收入情况如何，收购后整合情况如何？ 回答：2026 年上半年，东莞泰莱营业收入贡献 9,590.40 万元。 公司持续深化并购后的业务整合与战略协同，依托双方在技术研发、产品矩阵、客户资源及行业场景的互补优势，构建“视觉感知+运动执行+智能决策”一体化技术产品体系。一方面推进机器视觉与精密传动产品的深度融合，打通渠道与客户资源壁垒，推动两类核心产品交叉赋能、组合销售，拓展多元化落地场景；另一方面聚焦驱控一体化核心技术攻坚，深化底层研发协同，迭代升级配套软件与应用平台，补齐公司在精密运动控制领域的技术短板与产品缺口。本次并购整合有效完善了公司智能制造核心零部件全链条布局，强化了产品成套化、解决方案一体化交付能力，持续提升公司在高端智能制造领域的核心竞争力与行业壁垒。 问题6：介绍下公司的生态合作模式？ 回答：公司以“生态合作”为核心抓手，构建分层赋能、协同共进的合作伙伴体系：（1）分层赋能合作伙伴：根据企业所处阶段（初创期、成长期、成熟期），设计差异化合作模式，重点培育区域或垂直领域标杆企业，通过资源倾斜与联合品牌推广，助力伙伴树立行业影响力；（2）技术赋能与项目落地：开放技术平台与产品能力，提供从方案设计到实施的全链条支持；针对细分场景需求，联合开发定制化解决方案，提升客户价值；（3）服务全
--	---

	国及全球市场：依托生态合作模式，公司将产品能力与服务体系辐射至全国各区域及海外重点市场，通过本地化支持与协同服务，更高效地响应客户需求，助力全球制造业智能化升级。 公司始终秉持“一群人、一辈子、一件事”的初心，在为客户创造需求价值之外，持续深耕利益价值，以合力打造世界一流视觉企业的目标不断攀登。为更全面响应市场需求，推动产品化战略深化落地，公司聚焦以“产品市场化、品牌化”为核心的战略升级，通过生态合作模式链接行业伙伴，共同探索机器视觉技术的应用价值与市场潜力，构建可持续发展的利益共同体。 问题7：公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况？ 回答：公司向不特定对象发行可转换公司债券 127,000.00 万元已于 2026 年 8 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥普转债”，债券代码“118075”。 问题8：介绍下公司未来对行业、技术、产业等方面的规划？ 回答：展望未来，公司将继续围绕机器视觉核心主业与智能制造升级战略，坚持技术研发深耕与行业场景扩容双轮驱动，把握高端制造国产替代、工业 AI 渗透、柔性生产普及、具身智能迭代的行业发展红利，持续优化业务结构、夯实技术壁垒、拓宽增长空间。 行业拓展层面，公司将抓住传统 3C 电子、锂电行业景气机会，同时持续开拓半导体、汽车、光模块、先进 PCB 行业。3C 电子领域，紧跟终端产品形态创新、功能升级及制造工艺迭代趋势，针对行业前沿 3D 打印、一体化成型等新型精密制造工艺，深度联动核心客户开展前置化技术验证与方案适配，针对性挖掘新工艺带来的三维尺寸量测、曲面缺陷检测、成型精度校准等全新视觉增量需求，持续拓宽 3C 电子智能制造应用边界。锂电领域，全面覆盖动力、储能、消费电池全品类制造场景，持续深耕存量产线智能化改造与新增产能设备配套需求，巩固细分行业龙头优势。半导体与汽车领域，紧抓高端制造国产化机遇，重点拓展高精度尺寸量测、微观缺陷检测、精密对位引导、自动化装配等高端应用场景，加速自主可控视觉产品与解决方案在高端制造产线的规模化导入与批量落地。光模块/先进 PCB 领域，公司将推进打通光模块从芯片封装、耦合测试到成品组装以及先进 PCB 的全制造链路，实现全环节高精度质量管控。 技术研发层面，公司将持续维持高强度研发投入，聚焦工业 AI、3D 视觉、边缘计算、机器人视觉、运动控制协同等核心技术迭代创新，深耕具身智能、柔性制造等前沿技术领域，持续完善标准化、模块化产品平台。通过
--	--

	技术前置研发、产品快速迭代、方案场景化定制，进一步缩短项目交付周期、提升产品复用效率与工程落地能力，为新行业拓展、海外市场布局及高端场景渗透提供坚实的技术与产品支撑。 产业布局层面，公司将持续深化并购标的整合赋能，加速视觉感知、工业传感、精密运动控制、智能算法等多技术、多产品的融合协同，完善智能制造核心零部件全链条布局。同时积极布局机器人感知、智能驱控等新兴赛道，依托“视觉+AI+运动控制+传感”的一体化能力，打造适配新一代柔性智能制造的核心产品与解决方案，培育公司长期成长第二曲线。 整体而言，公司当前传统主业经营稳健，半导体、汽车等新兴赛道高速增长，技术研发、产品平台与产业布局持续完善，已形成多赛道协同、技术与市场双向赋能的良好发展格局，长期成长逻辑清晰、增量空间充足。后续公司将持续动态优化经营策略与资源配置，积极把握行业发展机遇，审慎应对宏观经济、下游资本开支波动、行业竞争、项目验证进度等不确定性因素，持续夯实核心竞争力，稳步推进公司高质量、可持续发展。
说明	投资者接待活动过程中，公司管理层积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定，回复的信息真实、准确，不涉及应当披露的重大信息。
附件清单（如有）	无